

Pressemitteilung:

Sensry und MST Gruppe gehen langfristig strategische Zusammenarbeit ein

Die Unternehmen Sensry GmbH (Sensry) und Micro Systems Technologies (MST Gruppe) haben heute den Abschluss einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit bekannt gegeben, bei der Synergien zwischen und Interessen der beiden Unternehmen genutzt werden, um gemeinsam auf dem Markt des Internets der Dinge, bekannter als Internet-of-Things (IoT), zu wachsen.

Sensry und die MST Gruppe beabsichtigen, in den Bereichen Design, Entwicklung und Fertigung in der Aufbau- und Verbindungstechnik, bei SMT-Prozesse und im elektrischen Test der von Sensry entwickelten halbleiterbasierten IoT-Systemlösungen zusammenzuarbeiten.

Die aus dem Sensry-Geschäftsmodell durch die Verwendung eines Baukastens für eine universelle Sensorplattform erwachsenden Anforderungen an eine fortschrittliche Aufbau- und Verbindungstechnik werden durch das Serviceangebot und die Philosophie der MST Gruppe abgedeckt.

„Wir sind stolz darauf, die MST Gruppe als Entwicklungspartner und Zulieferer für die Massenfertigung unserer hochflexiblen IoT-Systemlösungen für unsere Kunden zu haben. Da wir darauf spezialisiert sind, kundenspezifische Lösungen mit mehreren verschiedenen Sensoren, unterschiedlichen Kommunikationskonzepten in geringen Baugrößen auf der Basis modernster Technologien zu entwickeln, ist die MST Gruppe eine perfekte Ergänzung unseres Fertigungsnetzwerks.“, sagte Konrad Herre, CEO von Sensry, und ergänzte für beide Partner: „Mit unserer Zusammenarbeit unterstützen wir das Wachstum der Halbleiterindustrie und der damit verbundenen Lieferkette in Europa, indem wir Kunden jeder Größe den Zugang zum IoT-Markt erleichtern, Markteinführungszeiten verkürzen und Produkte mit „Sicherheitslösungen hergestellt in Deutschland“ zu angemessenen Preisen anbieten.“

Christian Rössle, President Sales & Marketing der MST Gruppe, kommentierte: „Wir freuen uns, mit Sensry zusammenzuarbeiten und deren Kunden für IoT-Module aus den verschiedenen Märkten einen „One-Stop-Service“ für fortschrittliche Aufbau- und Verbindungstechniken aus unserem Standort in Berg (Oberfranken), Deutschland, anbieten zu können. Unser partnerschaftlicher Ansatz umfasst Fertigungslösungen auf der Grundlage unserer internen Herstellung von Leiterplatten und IC-Substraten sowie dem Angebot an Serviceleistungen für den elektrischen Test, gemeinsame Projekte zur Entwicklung von Halbleitergehäusen von der Muster- bis zur Massenfertigung, die Programmierung und Kalibrierung von Sensoren, sowie die komplette Logistik für Wafer-, Chips- und Komponenten- Lagerung, Kennzeichnung, Verpackung und dem Direktversand an die Kunden von Sensry.“

Medienkontakte

Sensry

Konrad Herre

k.herre@sensry.de

Tel.: +49 160 714 90 90

www.sensry.de

MST Gruppe

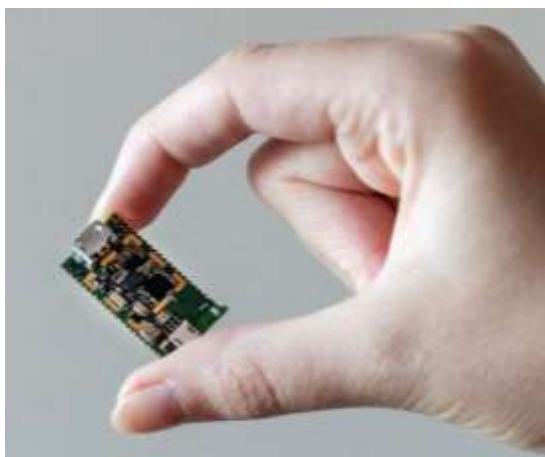
Christian Rössle

christian.roessle@mst.com

Tel.: +49 30 68905 4060

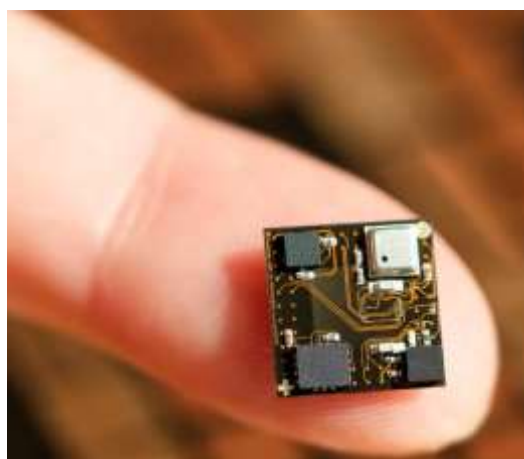
www.mst.com

sensry kallisto



Quelle: Fraunhofer Portugal, AICOS

sensry ganymed



Quelle: Fraunhofer Projekt USeP

Firmenprofile

Sensry unterstützt Kunden mit Sensor- und Sensorverschmelzungsknoten durch Entwicklung maßgeschneiderter, hochintegrierter, modularer Sensorsysteme, leistungsstarker Rechen- und Steuerungseinheiten sowie Kommunikationsschnittstellen. Die Systemkomponenten basieren auf den neuesten Technologien und werden in Zusammenarbeit mit Marktführern für die Serienproduktion hergestellt und mit Software Development Kits (SDK) unterstützt. Sensry wurde im November 2018 in Dresden, einem der Mikroelektronikzentren in Europa, gegründet und arbeitet mit mehreren Fraunhofer-Instituten in der Entwicklung und mit GLOBALFOUNDRIES in der Produktion zusammen.

Sensry bietet derzeit zwei Technologieplattformen an: "Sensry Kallisto", die bereits seit einigen Monaten mit zunehmenden Stückzahlen im Markt ist, und "Sensry Ganymed", die sich

in der letzten Entwicklungsphase befindet und Anfang 2021 ausgeliefert werden soll. Beide Plattformen zeichnen sich insbesondere durch ihre Modularität und Leistungsfähigkeit aus.

Kernkompetenzen:

- Bereitstellung von Plattformen für „Integrierte, intelligente und sichere Sensoren“,
- Design und Entwicklung flexibler universeller IoT-Anwendungen der Spitzenklasse:
 - Integration mehrerer verschiedener Sensoren,
 - Unterstützung mehrerer Kommunikationsstandards,
 - Geringer Stromverbrauch,
 - Hochleistungsprozessoren für Smart Node Computing,
 - Inhärente mehrschichtige Datensicherheit und Authentifizierung,
 - Angemessene Speicherressourcen,
- Zugang für KMU zu Spitzentechnologielösungen, welche für diese normalerweise nicht erschwinglich sind.
- Ermöglichung der „Demokratisierung der Digitalisierung“ in der Branche und in unserem täglichen Leben,
- Schnelles Design durch Verwendung von Standard-Bibliotheken und Chipllets,
- Kundenspezifische Modulkonfiguration mit kurzer Vorlaufzeit,
- Kleinster Formfaktor aufgrund fortschrittlicher Aufbau- und Verbindungstechnik,
- Komplette Unterstützung und Verwaltung der gesamten Lieferkette,
- Musterherstellung, Test, Hochlauf der Produktion, Skalierung auf hohes Volumen,
- Software- und Systemunterstützung (SDK, Treiber, Sicherheitssysteme, Dienste),
- Wireless API-Unterstützung für Benutzerkomfort und Akzeptanz.

Die **MST Gruppe** bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für High-Tech-Branchen, die außergewöhnlich hohe Leistungsanforderungen haben sowie höchste Qualität und Zuverlässigkeit erfordern, wie zum Beispiel in der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Sensoren und Aktoren. Das Unternehmen ist mit mehr als 1.100 Mitarbeitern in drei Ländern international aufgestellt und darauf ausgerichtet, integrierte Lösungen vom Konzept bis zur Serienproduktion Kunden anzubieten, die auf kleine und mittlere Fertigungsmengen spezialisiert sind.

Kernkompetenzen auf dem Gebiet der Aufbau- und Verbindungstechnik:

- Kundenspezifische Aufbau- und Verbindungstechniklösungen mit einer Vielzahl von Materialien, Formfaktoren und Konfigurationen, hermetisch und nicht-hermetisch,
- Integrierte Lösungen vom Konzept bis zur Serienproduktion (Spezifikation, Design, Musterfertigung und Serienfertigung marktfähiger Produkte),
- Eigenfertigung von organischen und keramischen IC-Substraten und PCBs,
- Eine breite Palette fortschrittlicher System-in-Package (SiP) und Surface-Mount-Technology (SMT) Aufbauprozessen,

- Flexible Fertigungsinfrastruktur, kostengünstige Produktion von Mustern und Massenproduktion kleiner und mittlerer Stückzahlen unter einem Dach,
- Kompromisslose Qualitätspolitik, zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 13485 sowie in Übereinstimmung mit den relevanten branchenspezifischen Standards;
- Vollständige Rückverfolgbarkeit von Materialien und Prozessen,
- Programme für nachhaltige Entwicklung, kontinuierliche Verbesserung von Prozessen, strategische Partnerschaften, erfahrene und kompetente Mitarbeiter.